

2026.6.10 Wed. 12 Fri. 10:00~17:00

東京ビッグサイト西3ホール 主催:株式会社JTBCコミュニケーションデザイン



センシング・半導体後工程の最先端に触れる3日間!

Smart Sensing 2026

未来社会を創造するセンサ・センシングテクノロジー、AI、データ活用サービスが一挙展示!

センサからAI、データ活用サービスまで、未来の可能性を広げる技術、製品が一堂に。最先端の電子デバイスやセンシング技術を通じて、製品開発や技術導入、ビジネスパートナーの開拓にお役立てください。

SEMISOL 2026
半導体後工程技術&ソリューション展

半導体後工程を支える最新技術・材料・部品・ソリューションなどを一堂に展示!

チップレット技術やパッケージング技術をはじめ、半導体後工程の革新を支える技術とソリューションが集結する専門展示会です。半導体後工程を支える技術・材料などをご覧ください。

Exhibitors List (2026年4月9日現在 法人格省略)

Smart Sensing 2026

- アイクリスタル
- iFlasco
- イノベーションリサーチ
- SIJテクノロジー
- NSW
- エネルギーハーベスティングコンソーシアム
- エムティアイ
- ガゾウ
- 金沢大学振動発電研究室
- Qception
- QuantumCore
- クローネ
- 慶應義塾大学ハプティクス研究センター
- 小糸製作所
- コーデンシ
- 産業技術総合研究所
次世代スマートテキスタイル製品化
コンソーシアム
- 産業技術総合研究所
製造基盤技術研究部門
- 産業技術総合研究所
センシング技術研究部門
- 産業技術総合研究所
人間社会拡張研究部門
- ジャパンディスプレイ
- 伸光製作所
- 住友金属鉱山
- センシリオ
- ソフトエイジェンシー
- 太陽機械製作所
- 千歳市/公立千歳科学技術大学
- ディジインターナショナル
- データケミカル
- 東邦電子
- 内藤電誠町田製作所
- フタバ企画
- ボールウェーブ
- ホルトプラン
- まちづくりデザインWEEK
- ヤシマ電気
- 横山商会
- リンテック
- ロボティック普及促進センター

SEMISOL 2026
半導体後工程技術&ソリューション展

- エスペック
- MI-6
- 機能性フィルム研究会
- 栄和化工
- ZACROS
- ニチモウ
- きもと
- 九州セミコンダクターKAW
- グローバルインフォメーション
- コネクテックジャパン
- 島津テクノリサーチ
- スマートモア
- 電子情報技術産業協会(JEITA)
- 日本特殊陶業
- 日本コーティングセンター
- マイクロモジュールテクノロジー
- 龍谷大学イノベーション推進センター

出展者は今後も追加予定
最新情報はこちらから ▶



Co-Creation Booths テクノロジーやビジネス・アイデアを体験・体感し、ビジネスコラボレーションに繋げる企画展示

自立電源型IoTパビリオン

振動発電デバイスや熱電モジュール、磁歪合金単結晶、IoTシステム構築など、自立電源型IoT関連の製品・技術が集中展示される「自立電源型IoTパビリオン」がSmart Sensing展示会場内に登場! デバイスメーカー、大学、エンドユーザーなどの皆様とオープンイノベーションを加速します。最先端の環境発電技術・自立電源型IoT技術に触れてください。



データとAIが導く未来ゾーン

知能化されたセンサから収集されるデータ活用に注目が集まっています。データとAIが協調・融合することで、新たな社会システムや基盤の構築、新サービスの実装など、出展者、来場者の共創によるビジネスを加速します。本展示では、新たな事業構想を描くうえで有望なニーズとシーズのマッチングを実現します。





会期中は連日「センサ・AI・IoT・半導体」の最先端技術をはじめとした、業界動向に関するセミナーを開催します。

講演は今後も追加予定。最新情報はこちらから ▶

■ Synergy Stage タイムスケジュール

聴講無料 要聴講登録

2026年4月9日現在 法人格省略

日時	セッションタイトル	講演者
6月10日 (水)	10:15 - 11:05	【基調講演】次世代AIを支える半導体後工程ソリューションの現在地と未来 横浜国立大学 総合学術高等研究院 半導体量子集積エレクトロニクス研究センター 教授 井上 史大氏
	11:20 - 12:10	チップレット実装の未来をひらく“受託開発・受託製造”一貫ビジネスモデル CADN(キャダン:Chiplet Ameba Development Network) コネクテックジャパン 代表取締役 会長 平田 勝則氏
	13:30 - 15:00	においセンサパネルディスカッション モデレーター: 物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 グループリーダー 吉川 元起氏 パネリスト: Qception 代表取締役 今村 岳氏 におい科学研究所 代表 喜多 純一氏
6月11日 (木)	10:15 - 11:05	人間拡張とフィジカルAI 人間拡張は完全自動化への過渡的技術ではない 産業技術総合研究所 フェロー 持丸 正明氏
	午後	先端半導体を創る後工程技術 ※詳細は4月下旬以降に公式WEBにてご確認ください。
		SATAS活動の最新情報について(仮) 半導体後工程自動化・標準化技術研究組合 理事長 / 元インテル 代表取締役 会長 鈴木 国正氏 他
	高信頼な車載AI半導体の後工程技術開発 大阪大学産業科学研究所 フレキシブル3D実装協働研究所 所長/特任教授 菅沼 克昭氏	
6月12日 (金)	10:30 - 11:30	光電融合半導体パッケージの最新動向と産業技術総合研究所の取り組み 産業技術総合研究所 光電融合研究センター センター長 天野 建氏
	13:00 - 16:30	JEITAチップレットセミナー ※詳細は4月下旬以降に公式WEBにてご確認ください。

■ TECH Stage 主催者セミナー タイムスケジュール

聴講無料 要聴講登録

6月10日 (水)	13:00 - 13:45	リモート管理を実現するスマートセンシング向けディジ無線通信ソリューション ディジインターナショナル フィールドアプリケーションエンジニア 湯澤 貴哉氏
	14:00 - 14:50	センサー×振動発電: サプライチェーンから事例まで 金沢大学 北 翔太氏、高村 亜由美氏 住友金属鉱山 / ヤシマ電気 / 横山商会
	14:50 - 15:30	エネルギーハーベスティングの現在地 ~ Ambient IoTの潮流 ~ エネルギーハーベスティングコンソーシアム / NTTデータ経営研究所 松末 竜氏
6月11日 (木)	11:20 - 12:05	AI時代を戦い抜く電子デバイス実装技術&人材 コネクテックジャパン 代表取締役社長 中野 高宏氏
	14:00 - 14:45	PFAS規制に対応するための製品分析 - 半導体分野に必要な検査視点 島津テクノリサーチ 環境事業部 分析研究センター 先端技術R&Dグループ 副グループ長 柴山 基氏
	15:00 - 15:45	新たな企業価値を生み出すフィジカルAIやヒューマノイドロボット活用の見極め方 ~ 中堅中小製造現場に劇的変容を促すことができるか ~ ロボットメディア 代表取締役 / ロボティック普及促進センター 理事長 小林 賢一氏

■ TECH Stage 出展者プレゼンテーション タイムスケジュール

聴講無料 事前登録不要

6月11日 (木)	13:00 - 13:15	講演タイトル調整中 SIJテクノロジー
6月12日 (金)	10:30 - 10:45	講演タイトル調整中 SIJテクノロジー
	11:30 - 12:00	最適な製造条件を探索するプロセスインフォマティクス アイクリスタル 代表取締役 高石 将輝氏
	14:00 - 14:30	プロセスインフォマティクスを圧倒的に加速するための生産技術DX アイクリスタル アプリケーション事業部 執行役員 アプリケーション事業部長 服部 優希氏

Floor Plan

Synergy Stage / Tech Stage

センサ、AI、半導体業界をリードする専門家をお招きし、基調講演、特別講演等を開催します。



Innovators' Networking

開催2日目には、出展者、来場者、講演者が気軽に交流できるネットワーキングを行います。様々な業種、職種が集まり、コミュニティを形成する交流の場となります。(参加無料)

Co-Creation Booths

- ・自立電源型IoTパビリオン
- ・データとAIが導く未来ゾーン

体験コーナー(予定)

2026年4月9日現在

来場方法のご案内

- 公式WEBから来場登録(無料) 来場事前登録制
- 出展者一覧 出展者情報をチェック!
- 来場者バッジを印刷して 展示会場へ
- 入場口で来場者 バッジを提示し入場 受付に並ばず 入場できます

ご来場のお問合せ

Smart Sensing/SEMISOL展示会事務局

(株)JTBコミュニケーションデザイン 〒105-8335 東京都港区芝3-23-1セレスティン芝三井ビルディング12階 E-mail:smartsensing@jtbcom.co.jp